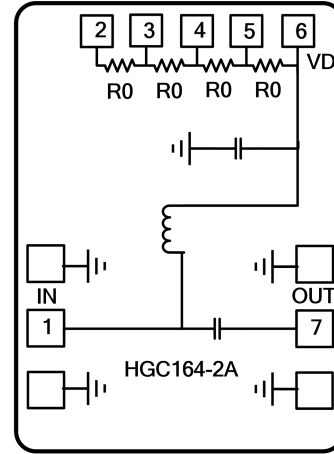




### 主要特点

- 可调节限流电阻
- 插入损耗: 0.5 dB
- 隔离度: 35 dB
- 芯片尺寸:  $1 \times 1 \times 0.1 \text{ mm}^3$

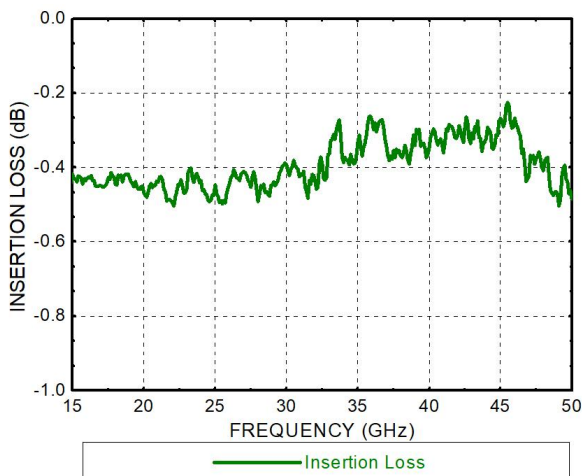
### 功能框图



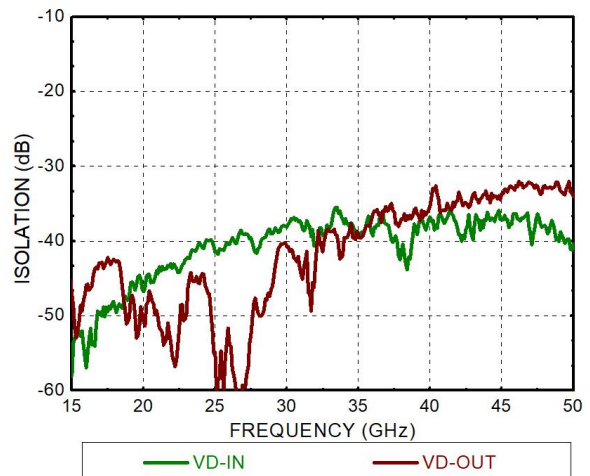
### 性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ )

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	18 - 50			GHz
插入损耗		0.5		dB
隔离度		35		dB
输入回波损耗		15		dB
输出回波损耗		15		dB

### 插入损耗

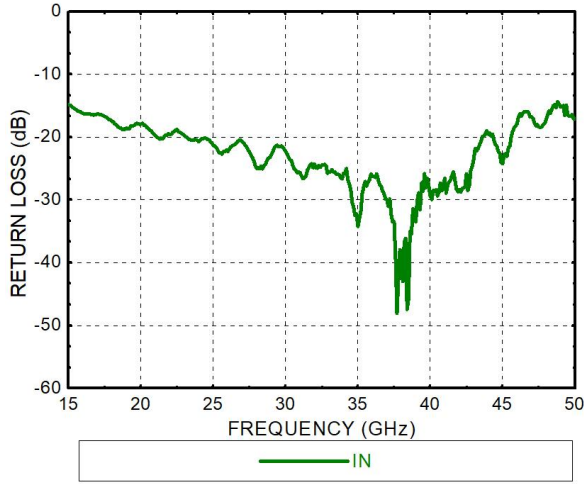


### 隔离度

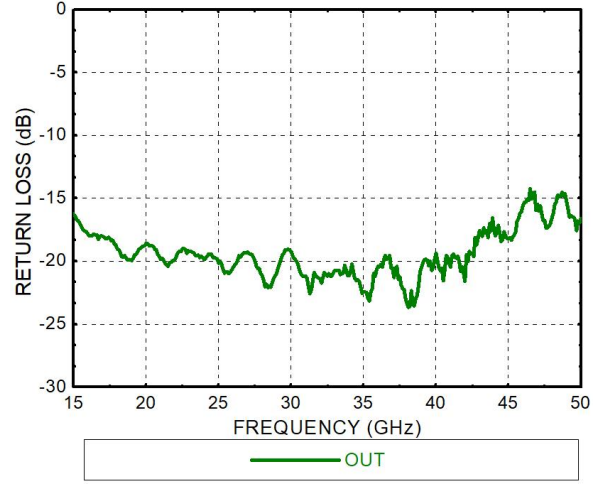




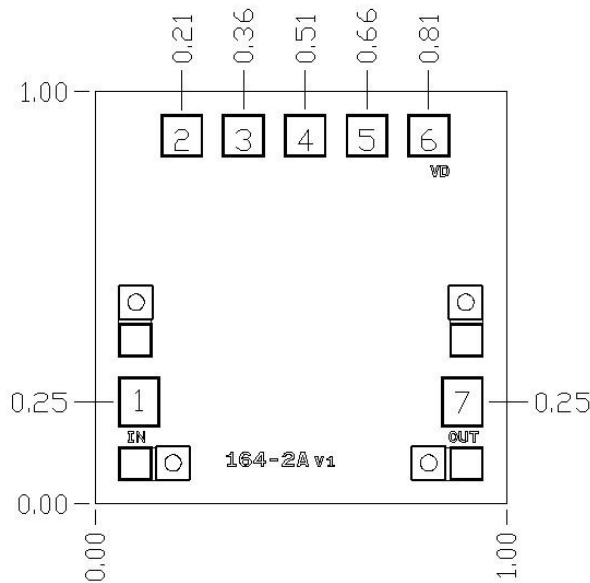
输入回波损耗



输出回波损耗



物理参数

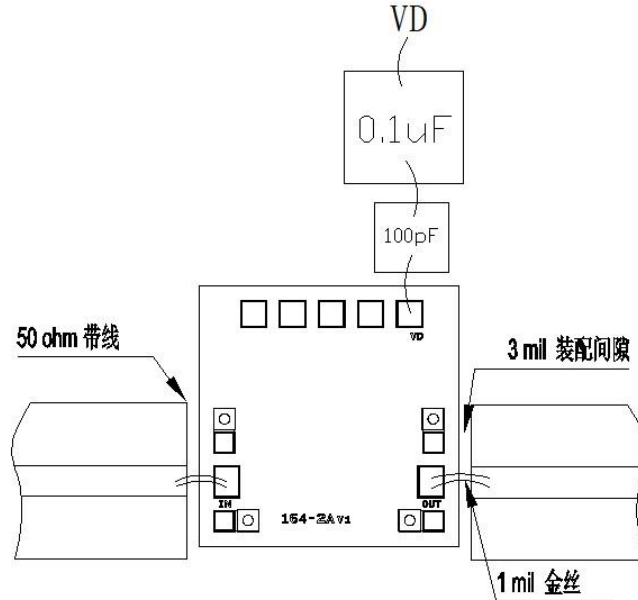


焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是射频输入端口
7	OUT	该焊盘是射频输出端口
2, 3, 4, 5, 6	VD	2-6 端口分别串入 40, 30, 20, 10, 0 欧姆电阻, 用于调节电流, 其中 R0 电阻为 10 欧姆
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



## 推荐装配图



### 注意事项

1. 芯片厚度为 100  $\mu\text{m}$
2. 典型键合焊盘尺寸为  $100 \times 100 \mu\text{m}^2$
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

### 极限参数

1. 最大承受直流电流: 200 mA
2. 射频输入功率: +37 dBm
3. 储存温度:  $-65 \sim +150 \text{ }^\circ\text{C}$
4. 工作温度:  $-55 \sim +85 \text{ }^\circ\text{C}$